

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2024-010

## 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”或“公司”）2020年首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，现将相关情况公告如下：

### 一、首次公开发行股票募集资金基本情况

#### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013号文同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43,000,000股，发行价格为每股人民币17.55元，募集资金总额为人民币754,650,000.00元，扣除发行费用人民币54,139,793.98元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币700,510,206.02元。上述募集资金实际到位时间为2020年9月24日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公W[2020]B097号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及2020年首次公开发行股票募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

#### （二）募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、2020年10月14日召开第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于募投项目金额调整的议案》，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
1	功能性材料扩产及升级项目	50,000.00	50,000.00	50,000.00	苏州世诺新材料科技有限公司
2	研发中心建设项目	12,365.20	12,365.20	12,365.20	苏州世华新材料科技股份有限公司
3	补充流动资金	18,000.00	7,685.82	7,685.82	苏州世华新材料科技股份有限公司
合计		<b>80,365.20</b>	<b>70,051.02</b>	<b>70,051.02</b>	

公司于2021年10月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“功能性材料扩产及升级项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至2024年2月，同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至2025年3月并新增全资子公司世晨材料技术（上海）有限公司为实施主体、对应的新增实施地点为上海紫竹高新技术产业开发区。具体内容详见公司于2021年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-044）。

公司于2022年8月26日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案》，同意公司部分变更“研发中心建设项目”并调整项目投资总额及投入募集资金金额。变更后，原“研发中心建设项目”投资总额及投入募集资金金额由12,365.20万元调整为6,865.20万元，部分变更募集资金5,500.00万元，用于新增“创新中心项目”的投资。具体内容详见公司分别于2022年8月27日和2022年9月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的公告》（公告编

号：2022-034）、《苏州世华新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-046）。

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。

上述调整后，公司首次公开发行股票募投项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体	预计达到完全可使用状态
1	功能性材料扩产及升级项目	50,000.00	50,000.00	50,000.00	苏州世诺新材料科技有限公司	2024 年 2 月
2	研发中心建设项目	12,365.20	6,865.20	6,865.20	苏州世华新材料科技股份有限公司、世晨材料技术（上海）有限公司	2025 年 3 月
3	创新中心项目		5,500.00	5,500.00	世晨材料技术（上海）有限公司	2026 年 5 月
4	补充流动资金	18,000.00	7,685.82	7,685.82	苏州世华新材料科技股份有限公司	已结项
合计		<b>80,365.20</b>	<b>70,051.02</b>	<b>70,051.02</b>		

## 二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

### （一）本次结项的募投项目募集资金具体使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“研发中心建设项目”，该项目已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件。截至本公告披露日，本次结项募投项目募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	累计已投入募集资金 (2)	利息及理财收益 (扣除手续费) (3)	预计节余募集资金 金额 (4)
研发中心 建设项目	12,365.20	6,865.20	7,036.53	852.33	681.00

注1：预计节余募集资金金额（4）=（1）-（2）+（3），实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准，预计节余募集资金金额包含尚未收到的银行利息收入。

注2：预计节余募集资金金额包含该募投项目尚待支付的合同尾款、质保款、保证金等款项，该部分支出后续将通过自有资金支付。

注3：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

对应的募集资金专户存储情况：

单位：万元

募投项目	开户主体	开户银行	专户账号	截至本公告披露 日余额
研发中心 建设项目	苏州世华新材料科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001014200557868	681.00
	世晨材料技术（上海）有限公司		8112001013300630805	0.00

## （二）本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

1、在项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

3、本次募投项目节余募集资金金额包含该募投项目尚待支付的合同尾款、质保款、保证金等款项，因上述款项支付时间周期较长，将节余募集资金补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。在该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。

## （三）本次结项的募投项目节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，该项目结项后，公司将“研发中心建设项目”节余募集资金681.00万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），届时公司将注销募集资金专户（账号：8112001014200557868，8112001013300630805，开户行：中信银行股份有限公司苏州分行），公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2024年2月29日